

Systemy klejenia okładzin ceramicznych i kamiennych

Przewodnik

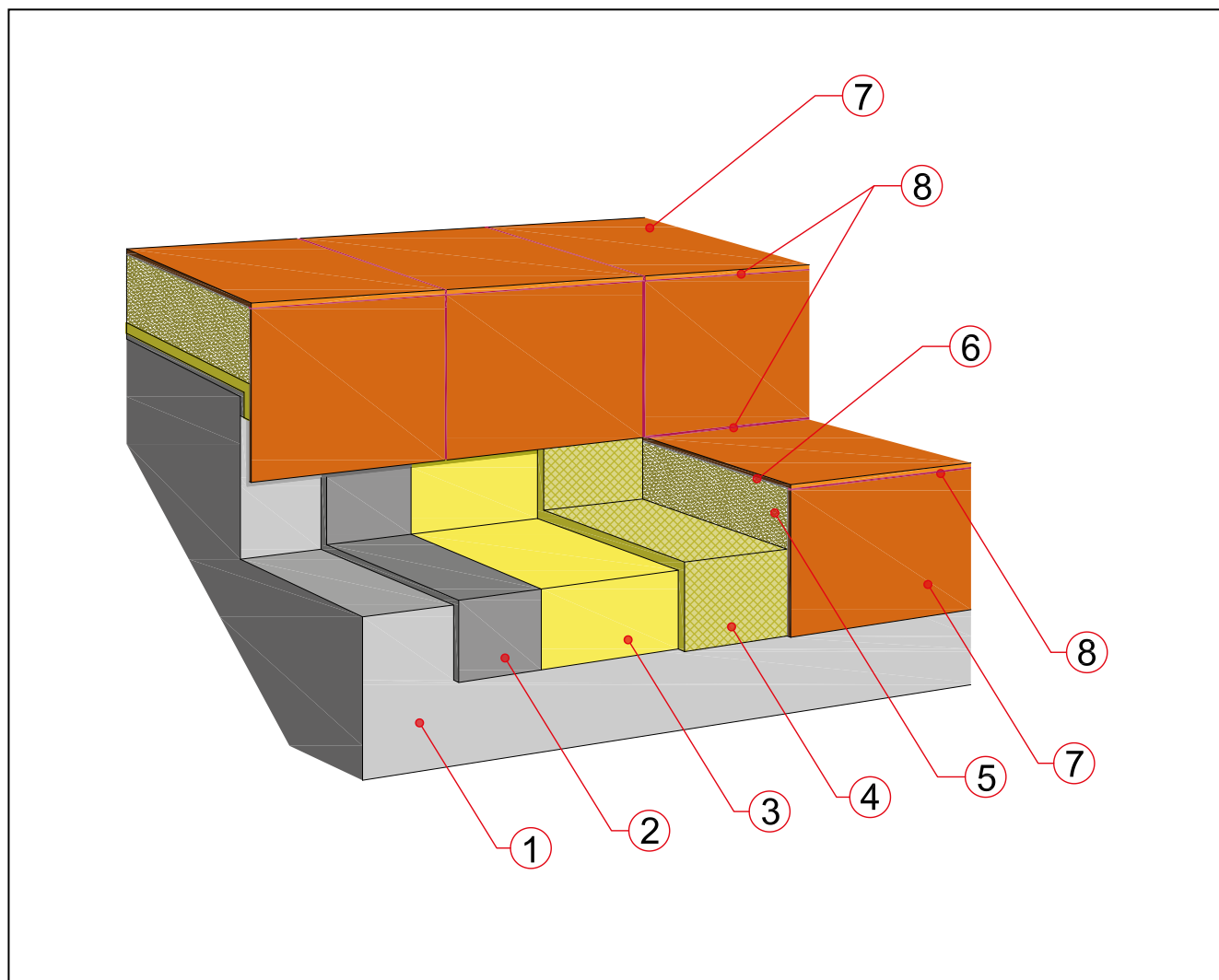


A brand of

BASF

We create chemistry

14. Płytki na hydroizolacji średniej-schody zewn.



Nr	Elementy systemu	Produkt PCI	Opis produktu
1	Beton		
2	Warstwa wyrównawcza	PCI Nannocret R2	
3	Uszczelnienie	PCI Seccoral 2K	Elastyczna 2-składnikowa izolacja mineralna
4	Mata drenująca		np. Aqua-Drain SD + Gittex AKS z firmy Gutjahr
5	Masa drenująca	PCI Pavifix DM	Cementowa zaprawa drenująca
6	Klej do płytek	PCI Pericol Flex	Elastyczny klej cementowy w metodzie kombinowanej
7	Płytki		
8	Fuga	PCI Nanofug Premium	Elastyczna fuga cementowa
		PCI Pericolor Flex	Elastyczna fuga cementowa

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obciążenia

Okładziny płytkowe na schodach występują przy obiektach o bardzo różnej funkcji, głównie mieszkalnych i biurowych. Zazwyczaj są to schody posadowione na gruncie, ale mogą mieć także formę biegów opartych na skośnych płytach żelbetonowych ponad terenem. Zależnie od swej wielkości i funkcji przyległego budynku ich podstawowym obciążeniem jest ruch pieszy - pojedynczych osób lub dużych grup. Narażone są ponadto na działanie naprężeń, wynikających ze zmiennych warunków klimatycznych: różnic temperatury powietrza, opadów deszczu i śniegu, powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania. Układ ich warstw mógłby powielać rozwiązania, przyjęte dla tarasów na gruncie lub balkonów, ale ze względu

na utrudniony spływ wody w warstwie kleju do płytek, wywołany naprzemiennym występowaniem płaszczyzn lekko nachylnych (stopień) i pionowych (podstopień), dochodzi tu często do obfitych wykwitów solnych poprzez fugi. Rozwiązaniem tego problemu jest odwodnienie drenażowe, przedstawione poniżej. Ma ono charakter ogólny, odpowiadający schematowi powyżej i winno być adaptowane w drodze indywidualnego projektu do każdorazowej sytuacji.

Podłoże

Zakłada się, iż podłożem są odpowiednio wykonane schody żelbetowe ze spadkiem. Przygotowane podłoże winno być czyste, nośne (brak rys, wykruszeń itp.). W razie konieczności szybkiego wyrównania, np. dla nadania spadku, można zastosować cementową szpachlówkę do betonu **PCI Nanocret R2**. W podłożu winny być widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje.

Wykonawstwo

A. USZCZELNIENIE PODPŁYTKOWE

W momencie aplikacji uszczelnienia podłoże winno być zwilżone (matowo-wilgotne). Jako pierwszą wykonuje się wtartą dokładnie w podłoże sztywnym pędzlem warstwę kontaktową z rozcieńczonej wodą zaprawy **PCI Seccoral 2K** (dodać ok. 5% wody). Po przeschnięciu warstwy kontaktowej na tyle, iż można na nią wchodzić bez obawy uszkodzenia, wykonuje się warstwę właściwą uszczelnienia w konsystencji nierozrzedzonej, zaczynając od wklejenia w wymaganych miejscach (patrz szczegóły) taśm **PCI Pecitape Objekt**. Dla kontroli wymaganej grubości nanoszenie zaprawy najlepiej wykonać packą zębatą i wygładzić grzebieniem gładką stroną packi. Zalecana grubość uszczelnienia w stanie utwardzonym to 1,5 - 2,0 mm.

B. WARSTWY DRENUJĄCE

Na uszczelnieniu (na stopniach i podstopniach) należy rozłożyć matę drenującą, np. Aqua-Drain SD + Gittex AKS z firmy Gutjahr. Następnie na stopniach układa się warstwę min. 5 cm cementowej zaprawy drenującej **PCI Pavifix DM**.

C. WYKLEJENIE PŁYTEK

Do mocowania okładziny płytkowej należy stosować cementowy klej elastyczny **PCI Pericol Flex** w metodzie kombinowanej.

D. SPOINOWANIE PŁYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: **PCI Nanofug Premium** lub **PCI Pericolor Flex**. Szerokość fug zależy od rozmiaru płytek, ale jako minimalną zaleca się 5 mm.

W dylatacjach należy wypełnić spoiny uszczelniaczem poliuretanowym **PCI Elritan 140** ewentualnie **PCI Elritan 100**, gruntując od strony płytek środkiem **PCI Elastoprimer 145**. Pod uszczelniaczem umieścić wałek dylatacyjny.

Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.